

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

799

ML6

Erstellt:

Bierlein, Tobias

Kunde:

Datum:

27.11.2018



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	361		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
C-RS-FR4-ML-0.20mm-105+105-TG150-HF	50201429	105	L2	4
		200		
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	268		5
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7
C-RS-FR4-ML-0.20mm-105+105-TG150-HF	50201429	105	L4	8
		200		
		105	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	368		9
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		10
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	11

B00:

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1853 µm

Version 1.2.18.12

© Würth Elektronik